

プラスチックBGA用基板

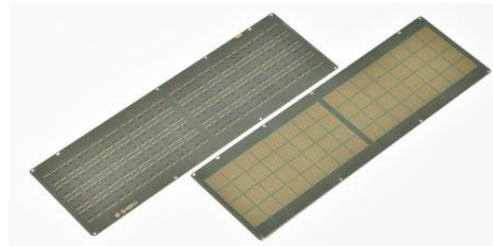
特徴

■ プラスチックBGA用基板

ロジック、メモリ、センサー等のICチップを実装するBGAパッケージ向けにプリプレグを使用した有機基板を提供しています。

- 2層/4層 貫通スルーホール基板
 - ・ 低価格、高信頼性
 - ・ 優れた電気特性
- ビルドアップ基板 ~IVH~
 - ・ 薄コアの適用により基板薄型化に対応 (例：4層 総厚150 μ m以下)
 - ・ 4層以上の多層構造が可能
 - ・ ワイヤーボンディング、フリップチップ接続ともに対応可能
 - ・ セミアディティブプロセスおよび層間レーザービアの適用により高密度配線が可能
 - ・ コア基板の貫通スルーホール上のビア、ビアスタック構造に対応

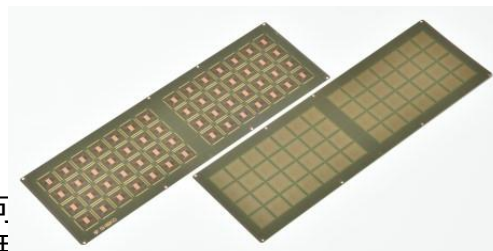
*IVH : Interstitial Via Hole



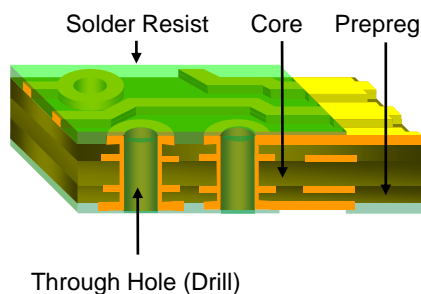
■ プラスチックBGA用コアレス基板 ~IVH3~

IVHのテクノロジーを用いた薄型コアレスビルドアップ基板を提供しています。

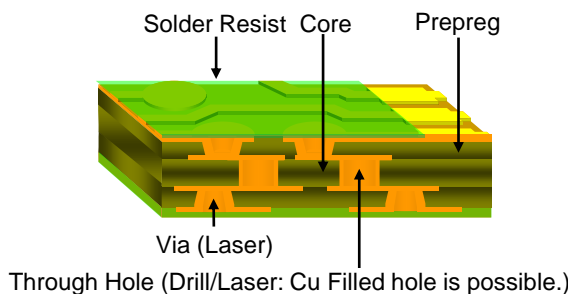
- ・ コア層を除去することにより究極の薄型化が可能 (例：3層 総厚80 μ m以下)
- ・ 優れた電気特性
- ・ 3層以上の多層化が可能
- ・ ワイヤーボンディング、フリップチップ接続ともに対応可能
- ・ セミアディティブプロセスおよび層間レーザービアの適用により、高密度配線が可能
- ・ ビアスタック構造に対応



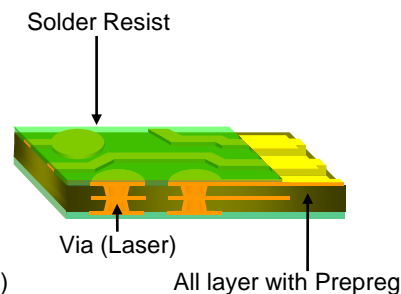
構造



4層貫通スルーホール基板



4層IVH



3層IVH3

新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

